

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

②① Anmeldenummer: 88890192.3

⑤① Int. Cl.⁴: **H 01 J 37/34**
C 23 C 14/34

②② Anmeldetag: 20.07.88

③① Priorität: 24.07.87 AT 1881/87 01.09.87 AT 2193/87

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
25.01.89, Patentblatt 89/04

④④ Benannte Vertragsstaaten:
CH DE ES FR GB IT LI NL SE

⑦① Anmelder: MIBA Gießlager Aktiengesellschaft
Dr.-Mitterbauer-Strasse 3
A-4663 Laakirchen (AT)

⑦② Erfinder: Gärtner, Walter, Dipl. Ing.
Anton Schosserstrasse 27
A-4810 Gmunden (AT)

Koroschetz, Franz, Dipl. Ing. Dr.
Rustonstrasse 5
A-4810 Gmunden (AT)

Wagendristel, Alfred, Dipl. Ing. Dr.
Franz Veselygasse 9
A-2380 Perchtoldsdorf (AT)

Bangert, Herwig, Dipl. Ing. Dr.
Rudolf Walzenkorngasse 45
A-1235 Wien (AT)

⑦④ Vertreter: Hübscher, Helmut, Dipl.-Ing.
Patentanwälte Dipl.-Ing. Gerhard Hübscher Dipl.-Ing.
Helmut Hübscher Dipl.-Ing. Heiner Hübscher
Spittelwiese 7
A-4020 Linz (AT)

⑤④ Stabförmige Magnetron- bzw. Sputterkathodenanordnung, Sputterverfahren, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens und rohrförmiges Target.

⑤⑦ Die Erfindung betrifft eine stabförmige Magnetron-Sputterkathodenanordnung mit einem innenliegenden, gekühlten Permanentmagnetsystem und einem Trägerrohr für das Target. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß zwischen den aus einem oder mehreren, insbesondere austauschbar auf das Trägerrohr (36) aufgezogenen Ring(en) (37, 37', 37'') bestehenden Target und dem Trägerrohr (36) zumindest eine Wärmekontaktschicht (38) angeordnet ist. Während des Sputterns können die Kathode (6) und die zu besputternde Fläche einer gegenseitigen Relativbewegung in Längsrichtung, der Kathode (6) unterworfen werden, wozu eine Verstelleinrichtung vorgesehen ist. Die Magnete (31) sind mit in Längsrichtung des Trägerrohres (36) alternierend entgegengesetzter Richtung ihres Magnetfeldes innerhalb des Trägerrohres (36) angeordnet. Sie besitzen zylindrische oder polygonale Mantelflächen und parallele und im Winkel (α) zur Längsrichtung der Elektrode (6) bzw. Welle (30) geneigt verlaufende Endflächen (44).

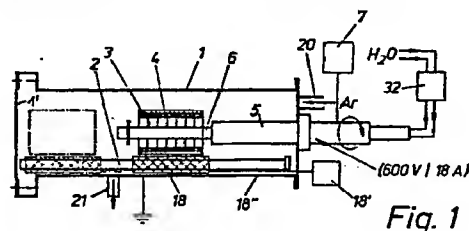


Fig. 1

Beschreibung

Stabförmige Magnetron- bzw. Sputterkathodenanordnung, Sputterverfahren, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens und rohrförmiges Target

Die Erfindung betrifft eine stabförmige Magnetron-Sputterkathodenanordnung mit einem innenliegenden, gekühlten Permanentmagnetsystem und einem Trägerrohr für das auf das stabförmige, vorzugsweise aus nichtmagnetischem Stahl, bestehende Trägerrohr aufgebrachte, gegebenenfalls aus unterschiedlichen Targetmaterialien zusammengesetzte Target. Derartige Anordnungen dienen insbesondere zum Besputtern von zumindest teilweise gekrümmten Flächen bzw. von Innflächen von hohlen oder aus Teilen zu solchen zusammengesetzten Körpern, z.B. von Zylinderinnenflächen polygonen oder rosettenförmigen Innenflächen od. dgl. Ferner betrifft die Erfindung ein Sputterverfahren zum Sputtern mit einer Magnetron- bzw. Sputterkathodenanordnung, vorzugsweise zum Besputtern von gekrümmten Bereichen aufweisenden Flächen, z.B. den Innenflächen von Hohlkörpern sowie eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens und ein rohrförmiges Target.

Aus der US-PS 452 12 86 ist eine Ätz- bzw. Beschichtungseinrichtung mit einer Hohlkathode mit parallelen Elektrodenflächen bekannt; eine stabförmige Magnetron-Sputterkathodenanordnung ist nicht vorhanden.

Aus der EP-A1 70 899 ist eine Magnetron-Sputterkathodenanordnung der eingangs genannten Art bekannt, die zum Besputtern ebener Flächen eingesetzt wird. Bei dieser Anordnung ist ferner vorgesehen, daß die zu besputternde Fläche senkrecht zur Achse der ortsfesten Kathodenanordnung, die ein Trägerrohr umfaßt, auf das unterschiedliche Targetmaterialien aufgebracht sind, bewegt wird und daß das Trägerrohr um dessen Längsachse insbesondere kontinuierlich rotierbar ist, so daß z.B. verschiedene Materialien, die in verschiedenen Sektoren angeordnet sind, nacheinander vor dem nur in einem bestimmten Sektor innen angeordneten, U-förmigen und gekühlten Permanentmagnetsystem in Position gebracht werden können.

Ziel der Erfindung ist es, Materialien, die aus Festigkeitsgründen für eine Fertigung selbsttragender Targets ungeeignet sind, und beliebige Materialkombinationen, die durch andere Verfahren (z.B. galvanisch, schmelz- oder pulvermetallurgisch) nicht oder nur schwer herstellbar sind, einem Hochleistungssputterprozeß zugänglich zu machen, die strukturelle Ausbildung der aufgesputterten Beschichtungen, z.B. auf der Innenfläche von Lager-schalen, zu verbessern bzw. die Haftung derartiger Schichten zu erhöhen. Ferner sollen die aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Targetmaterial und Trägerrohr und der oft unzureichenden Wärmeabfuhr vom Targetmaterial auftretenden Probleme gelöst werden. Probleme bei der Wärmeabfuhr ergeben sich oft bei der Verwendung stabförmiger Kathoden mit kleinem Durchmesser.

Dieses Ziel wird bei einer stabförmigen Magnetron- bzw. Sputterkathodenanordnung der eingangs genannten Art dadurch erreicht, daß zwischen den

aus einem oder mehreren, insbesondere austauschbar auf das Trägerrohr aufgezogenen Ring(en) bestehenden Target und dem Trägerrohr zumindest eine Wärmekontaktschicht angeordnet ist.

Die zwischen dem Trägerrohr und den Ringen aus Targetmaterial angeordnete Wärmekontaktschicht aus Metall ermöglicht einen optimalen Wärmeübergang von dem durch die Gasentladung erhitzten Targetmaterial zum Trägerrohr und von dort auf ein zwischen dem Trägerrohr und dem Permanentmagnetsystem fließendes Kühlmittel. Damit wird erreicht, daß das Targetmaterial ausreichend gekühlt wird, d.h. bei entsprechend hoher Leistungsdichte nicht aufschmilzt. Es kann dadurch auch ein dickeres Targetmaterial verwendet werden, womit die Standzeiten der Anordnung erhöht werden.

Auf Grund der erfindungsgemäßen Vorgangsweise ist es nicht mehr notwendig, die Kathode zur Gänze aus Targetmaterial zu fertigen, sondern es können beliebige Targetmaterialien, z.B. auch solche mit geringer mechanischer Festigkeit, die zur Fertigung selbsttragender Targets ungeeignet sind, aus dem Trägerrohr aufgezo-gen werden. Die erfindungsgemäße Sputterkathodenanordnung ermöglicht es erstmals, Schichten auch aus solchen Legierungen mit einer Stabkathode zu produzieren, für die eine schmelz- oder sinlertechnologische Herstellung von ringförmigen Targets bisher nicht bzw. nur unter größten Schwierigkeiten möglich war. Unterschiedliche Wärmedehnungen des Targetmaterials und des Trägerrohres werden von der Wärmekontaktschicht aufgenommen.

Bevorzugt ist es, wenn bei im Inneren des Trägerrohres um dessen Längsachse insbesondere kontinuierlich rotierbaren, z.B. von einer rotierbaren Welle getragenen und vom Kühlmittel umströmten Permanentmagneten die Magnete mit in Längsrichtung des Trägerrohres alternierend entgegengesetzter Richtung ihres Magnetfeldes innerhalb des Trägerrohres angeordnet sind. Diese Ausbildung der Kathodenanordnung bzw. des Permanentmagnetsystems ermöglicht eine gleichmäßige Abarbeitung bzw. Abtragung des Targetmaterials beim Sputtern und damit eine bessere Ausnützung des Targetmaterials sowie eine gleichmäßige Aufbringung der Schicht für die zu besputternden Flächen. Vorteilhaft ist es hierbei, wenn die zylindrische oder polygonale Mantelflächenbesitzenden Magnete parallel und im Winkel zur Längsrichtung der Elektrode bzw. Welle geneigt verlaufende Endflächen besitzen, wobei die einander zugewandten Endflächen aufeinanderfolgender Magnete entgegengesetzte Magnetpole aufweisen.

Um eine hohe Leistungsdichte auf der Targetoberfläche während eines Dauerbetriebes zu ermöglichen, ist insbesondere die Kühlung des Targetmaterials von Bedeutung. Dazu ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß die Magnete eine rohrförmige Ausnehmung in Längsrichtung des Trägerrohres aufweisen, mit der sie gegebenenfalls auf die Welle

aufgeschoben sind, daß die Ausnehmung bzw. die als Hohlwelle ausgebildete Welle als Kühlmitteldurchfluß ausgebildet und an eine Kühlmittelzufuhreinrichtung angeschlossen ist und daß die Magnete in dem Trägerrohr unter Ausbildung eines Spaltes angeordnet sind, wobei der Spalt zwischen dem Trägerrohr und den gegebenenfalls von einem Hüllrohr umgebenen Magneten als Kühlmitteldurchfluß, insbesondere Kühlmittelrückleitung, ausgebildet ist. Der hierdurch gegebene kreisringförmige Strömungsquerschnitt soll für das Kühlmedium bei der vorgegebenen Kühlmittelgeschwindigkeit eine Reynoldszahl > 10.000 ergeben. Die Dicke des Ringspaltes zwischen den Magneten bzw. dem Hüllrohr und dem Trägerrohr kann etwa 0,5 mm betragen und es wird ein Kühlwasserdruckkreislauf mit einem Druck von 12 bar ausgebildet. Im Endbereich der Hohlwelle kann eine strömungsgünstig geformte, schalenförmige Umlenkung für das aus der Hohlwelle austretende Kühlmittel vorgesehen sein, um dieses in den Kühlspace umzulenken.

Um die hohe Sputterleistungsdichte am Target zu erzielen, muß das Plasma in unmittelbarer Nähe der Targetoberfläche magnetisch eingeschlossen werden. Dazu ist eine wirksame magnetische Feldstärke parallel zur Zylinderoberfläche des Targetmaterials von vorzugsweise 300-Gauß erforderlich. Die ses Feld wird durch die Magnete erzeugt, die vorzugsweise aus SmCO_5 bestehen. Auf Grund der besonderen Konfiguration der einzelnen rotierenden aufeinander folgenden Magnete wird im zeitlichen Mittel eine gleichmäßige Dichte des Plasmas auf einem die Targetoberfläche umgebenden Zylindermantel erreicht. Daraus resultiert ein gleichmäßiger Abtrag des Targets. So kann z.B. mit der erfindungsgemäßen Stabkathode eine Beschichtungsrate von 1 $\mu\text{m}/\text{min}$ Aluminium im Abstand von 30 mm von der Targetoberfläche erreicht werden, welche Leistung bereits über der Grenze von handelsüblichen Hochleistungsflackkathoden liegt und die Leistung bekannter Stabkathoden bei weitem übertrifft.

Vorteilhaft ist es, wenn die zwischen dem(n) Ring(en) und dem Trägerrohr angeordnete, vorzugsweise 5 - 10 μm , insbesondere 10 - 20 μm , dicke Wärmekontaktschicht aus weichem bzw. verformbarem, insbesondere mit einer Härte < 20 MHV, niedrig schmelzendem, gut wärmeleitendem Metall bzw. einer solchen Legierung, z.B. In, Ga, Pb, Sn, od.dgl., besteht, die vorzugsweise auf das Trägerrohr abgelagert ist. Wenn die Wärmekontaktschicht einen größeren Ausdehnungskoeffizienten besitzt als die auf das Trägerrohr aufgezogenen Ringe, treten keine die Wärmeableitung behindernden Zwischenräume bei Erwärmung der Kathode auf. Gleichzeitig ist jedoch erforderlich, daß das Metall der Wärmekontaktschicht weich ist, um die entstehenden Spannungen unter Verformung aufnehmen zu können. Besonders vorteilhaft ist es, wenn ein Metall für die Wärmekontaktschicht eingesetzt wird, das bei Temperaturen unter dem Erweichungspunkt, insbesondere Schmelzpunkt, des jeweiligen Targetmaterials schmilzt und somit bei lokaler Überhitzung des Targetmaterials wegen lokal schlechten Wärmekontaktes durch Aufschmelzen der Schicht und Nachfließen des Schichtmaterials in die Bereiche den

Wärmeschluß wieder herstellt. Da die Ringe vorteilhaft mittels eines Preßsitzes auf das Trägerrohr aufgebracht sind, ergibt sich durch die gute Verformbarkeit des Metalls der Schicht ein optimaler Wärmeübergang auch bei nicht geschmolzenem Metall.

Zur Ausbildung von Schichten aus mehreren Einzelkomponenten ist es vorteilhaft, wenn auf das Trägerrohr in axialer Richtung aufeinanderfolgend insbesondere in vorbestimmter Reihenfolge Ringe gegebenenfalls unterschiedlicher Breite aus unterschiedlichem Targetmaterial aufgezogen sind.

Ein rohrförmiges Target, insbesondere für erfindungsgemäße Sputterkathodenanordnungen ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Trägerrohr des rohrförmigen Targets und dem Targetmaterial zumindest eine vorzugsweise 5 - 50 μm , insbesondere 10 - 20 μm , dicke Wärmekontaktschicht aus weichem bzw. verformbarem, insbesondere mit einer Härte < 20 MHV, niedrig schmelzendem, gut wärmeleitendem Metall oder einer entsprechenden Legierung, z.B. In, Ga, Pb, Sn, Wood'sches Metall od.dgl. vorgesehen ist, wobei auf das Trägerrohr in axialer Richtung zumindest ein, vorzugsweise eine Anzahl aufeinanderfolgender gegebenenfalls aus unterschiedlichen Targetmaterialien bestehender, gegebenenfalls unterschiedliche Breite besitzender, Ring(e) aufgebracht ist, wobei der (die) Ring(e) vorzugsweise in warmem Zustand auf das Trägerrohr aufgezogen und nach dem Abkühlen im Betriebszustand mit Preßsitz auf dem Trägerrohr bzw. der Wärmekontaktschicht angeordnet ist (sind), wobei gegebenenfalls das Metall der Schicht(en) einen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzt, der größer ist als der des Targetmaterials.

Das erfindungsgemäß Sputterverfahren, vorzugsweise zum Besputtern von gekrümmten Bereichen aufweisenden Fläche, z.B. der Innenflächen von Hohlkörpern, wobei die zu besputternde Fläche und die Kathodenanordnung, die ein Trägerrohr umfaßt, auf das unterschiedliche Targetmaterialien aufgebracht sind, einer gegenseitigen Relativbewegung unterworfen werden, wobei vorzugsweise die Kathodenanordnung lagefest gehalten und die Fläche bzw. der die Fläche tragende Körper bewegt wird, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Kathodenanordnung, auf deren Trägerrohr mehrere in axialer Richtung des Trägerrohres aufeinanderfolgende Ringe aus unterschiedlichem Targetmaterial aufgezogen werden, und die zu besputternde Fläche einer gegenseitigen Relativbewegung in Längsrichtung der Kathodenanordnung bzw. des Trägerrohres unterworfen werden. Dabei kann vorgesehen sein, daß die Relativbewegung zwischen der Kathodenanordnung und der zu besputternden Fläche eine Pendelbewegung ist, deren Hub größer als die Breite eines, insbesondere des breitesten vorhandenen, Ringes aus Targetmaterial gewählt ist oder daß die Relativbewegung eine Verschleibbewegung ist und eine Vorschubbewegung des die zu besputternde Fläche tragenden Körpers in bezug auf die Längsrichtung der Kathodenanordnung umfaßt, der eine Pendelbewegung überlagert ist. Auf diese Weise werden die durch die Targetsegmentierung bzw. die durch aufeinanderfolgend angeordnete

Ringe aus unterschiedlichen Targetmaterialien hervorgerufenen lokalen Konzentrationsunterschiede beim Aufbau der Schicht ausgeglichen und eine Schicht der gewünschten Legierung in gleichmäßiger Zusammensetzung erzielt.

Eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens mit einer Verstelleinrichtung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Kathodenanordnung und/oder die zu besputternde Fläche von der von einer in Längsrichtung des Trägerrohres eine Vorschub- und/oder Hin- und Herbewegung (Pendelbewegung) ausführenden Trägereinrichtung gebildeten Verstelleinrichtung, die gegebenenfalls von einer Förder- bzw. Antriebseinrichtung betätigbar ist, getragen bzw. mit dieser verbunden sind. Die Förder- bzw. Antriebseinrichtung für die zu besputternde Fläche und/oder für den die Fläche tragenden Körper kann mit der z.B. außerhalb des Rezipienten, in dem der Sputtervorgang vor sich geht, angeordneten Verstelleinrichtung verbunden sein, die über vakuumdichte Antriebe bzw. Stellanrichtungen die Verstellung des Körpers und/oder der zu besputternden Fläche während des Sputterns bewirken.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind der folgenden Beschreibung, der Zeichnung und den Patentansprüchen zu entnehmen.

Im folgenden wird die Erfindung an Hand der Zeichnung näher erläutert:

Es zeigen: Fig. 1 eine Sputterstation, Fig. 2 eine bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Sputterkathodenanordnung, Fig. 3 einen Detailschnitt durch eine Sputterkathodenanordnung und Fig. 4 eine Ansicht eines erfindungsgemäßen Targetrohres.

Besonders gut können die erfindungsgemäße Kathodenanordnung und das erfindungsgemäße Verfahren zum Besputtern von Lagerschalen mit Lagerschichtlegierungen eingesetzt werden. Demgemäß ist die Erfindung anhand der Beschichtung von Lagerschalen durch Kathodenzerstäubung ("Sputtern") als Beispiel näher erläutert. Andere Verwendungszwecke sind z.B. das Besputtern von Kugellageraufläufen, Rohrlinnenflächen usw.

Die vorteilhafterweise in einer Reihe zu einem Zylinder aneinandergefügt Lagerschalen werden in einen Träger 4 eingesetzt, der in eine Beschichtungsanlage einbringbar ist. Eine derartige Sputteranlage ist in Fig. 1 schematisch dargestellt. Die Anordnung umfaßt einen gasdichten Rezipienten 1 mit einem aufschraubbaren Deckteilk 1'. Im Rezipienten 1 sind Fördereinrichtungen, z.B. ein auf Führungen 2 verfahrbarer Träger 18, vorgesehen, auf bzw. mit denen der Träger 4 mit den Lagerschalen 3 zwischen einer Ein- bzw. Austragstellung (strichliert) und einer Sputterstellung verfahrbar ist, in der die Sputterkathode 6 von den Lagerschalen 3 umschlossen wird. Nach Beendigung des Sputtervorganges wird der Träger 4 dem Rezipienten 1 entnommen.

Mit 20 ist eine Gaszufuhrleitung und mit 21 eine Leitung zu einer Vakuumpumpe bezeichnet. Der Spannungsanschluß (z.B. -600 V) der Sputterkathode 6 ist mit 7 bezeichnet; die Kühlwasserzufuhreinrichtung der Kathode 6 mit 32. Das Sputtern erfolgt

bei einer Temperatur des Targetmaterials von 30 bis 100°C, vorzugsweise 80°C, und einem Druck von etwa $2 \cdot 10^{-3}$ mbar.

Eine erfindungsgemäße Kathodenanordnung 6, wie sie in Fig. 2 im Schnitt durch ihre Längsachse dargestellt ist, umfaßt auf einer Hohlwelle 30 angeordnete Permanentmagnete 31. Die Magnete sind im vorliegenden Fall zylindrisch ausgebildet, könnten aber im Querschnitt auch polygonal begrenzt sein. Die Magnete 31 sind im Winkel α schräg zur Längsachse der Kathodenanordnung 6 geschnitten und besitzen somit geneigte Endfläche 44. Der Winkel α beträgt vorteilhafterweise 45° bis 75°. Die Magnete 31 sind derart magnetisiert, daß ihre Pole in den Endflächen 44 liegen, u.zw. so, daß die Magnetisierungsrichtung parallel zur Längsachse der Kathodenanordnung 6 verläuft. Ferner sind aufeinanderfolgende Magnete 31 derart angeordnet, daß jeweils entgegengesetzt Magnetpole einander zugekehrt sind.

Die Magnete 31 erzeugen ein magnetisches Streufeld, das einen schräg zur Längsachse verlaufenden, ringförmigen Plasmaeinschluß 39 vor der Lagerinnenfläche 19 bewirkt. Durch die Rotation der Magnete wird eine Rotation der Plasmazonen bewirkt, wobei durch diese Taumelbewegung eine gleichmäßige Abstäubung von der Targetoberfläche erreicht wird.

Die Magnete sind in einem dünnen Hüllrohr 35 angeordnet und von einem Targetträgerrohr 36 umgeben, auf das Ringe 37,37' aus Targetmaterial aufgezogen sind. Zwischen den Ringen 37,37' aus Targetmaterial und dem Trägerrohr 36 ist eine Wärmekontaktschicht 38 aus weichem, gut wärmeleitendem, niedrig schmelzendem, verformbarem Material, z.B. Indium, Gallium, Blei od.dgl., angeordnet. Dieses Material soll ferner einen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzen, der größer ist als der des Targetmaterials. Die Anzahl, das Material, die Breite und die Dicke der Ringe werden vom Anwendungsfall bestimmt.

Die Hohlwelle 30 mit den schräg geschnittenen Magneten 31 ist innerhalb des Trägerrohres 36 rotierbar angeordnet. Zwischen den Ringen 37,37' und der Innenfläche 19 der Lager 3, die im Träger 4 in Reihen angeordnet sind, findet eine Gasentladung statt und die vom Targetmaterial abgetragenen Teilchen werden auf der Fläche 19 abgelagert.

Durch die Hohlwelle 30 wird Kühlmedium 41, vorzugsweise Wasser, von einer Kühlmittelzufuhreinrichtung 32 zugeführt und gelangt durch die Hohlwelle 30 zu einer schalen- bzw. halbtorusförmigen Umlenkung 47, mit der das Kühlmedium 41 aus der Hohlwelle 30 in einen zylindrischen Spalt 43 zwischen den Magneten 31 bzw. dem Hüllrohr 35 und dem Trägerrohr 36 geleitet wird. Aus dem Spalt 43 wird das Wasser aus der Kathodenanordnung 6 abgeführt.

Die Außenfläche der Magnete 31, die Außen- bzw. Innenfläche des Trägerrohres 36 und die Querschnittsform der Ringe können zylindrisch oder in Form eines Vielecks mit möglichst hoher Eckenanzahl ausgebildet sein.

Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt aus der konzentrischen Anordnung der zu beschichtenden Lager und

der Sputterkathodenanordnung. Zwischen dem Trägerrohr 36 und den Ringen 37, 37', 37'' aus unterschiedlichem Targetmaterial ist eine vorzugsweise 5 - 50 µm; insbesondere 10 - 20 µm, dicke Wärmekontaktschicht 38 aus weichem, niedrig schmelzendem, gut wärmeleitendem Metall, z.B. In, Ga, Pb od.dgl., vorgesehen. Diese Schicht besitzt eine Härte insbesondere < 20 MHV und einen Schmelzpunkt, der kleiner als die Erweichungs- bzw. Schmelztemperatur des jeweiligen Targetmaterials ist. Die aufeinanderfolgenden Ringe 37, 37', 37'' aus gegebenenfalls unterschiedlichen Targetmaterialien sind vorzugsweise in warmem Zustand auf das Trägerrohr 36 aufgezogen und sitzen nach dem Abkühlen mit Preßsitz auf dem Trägerrohr 36 bzw. der verformbaren Wärmekontaktschicht 38. Die Ringe können verschiedene Breiten aufweisen, besitzen vorzugsweise jedoch gleiche Wandstärke. Gemäß Fig. 2 sind zwischen breiten Al-Ringen 37 schmale Pb-Ringe 37' dargestellt, womit sich Al-Pb-Legierungen aufspütern lassen.

Es können auch mehrere Wärmekontaktschichten 38 übereinander vorgesehen werden bzw. anstelle von Reinmetallen für die Schicht 38 sind auch Legierungen, z.B. Wood'sches Metall, Sn-Pb-Legierungen usw. einsetzbar. Es ist auch möglich, nur einen Ring bzw. Zylinder auf ein Targetrohr 36 aufzuziehen.

Fig. 4 zeigt eine Ansicht eines abwechselnd Ringe 37 bzw. 37' aus unterschiedlichen Materialien tragenden Trägerrohres 36, das auf das Permanentmagnetsystem aufsteckbar ist und in der Halterung 5 befestigt wird.

Mit 18 ist in Fig. 1 eine Einrichtung angedeutet, mit der der die Lagerschale 3 tragende Träger 4 auf Führungseinrichtungen 2, z.B. Schienen, in eine Relativbewegung zum Trägerrohr 36, insbesondere eine Vorschubbewegung und/oder Hin- und Herbewegung bzw. Pendelbewegung in Längsrichtung der Kathodenanordnung 6 und/oder in eine Rotation um diese versetzbar ist. Durch derartige Bewegungen kann das Aufspütern von Legierungsschichten mit nebeneinanderliegenden Ringen 37, 37', 37'' aus unterschiedlichen Materialien gleichmäßig werden. Mit 18' ist eine außerhalb des Rezipienten 1 angeordnete Antriebseinrichtung, z.B. ein Motor, und mit 18'' sind vakuumdicht geführte Kraftübertragungseinrichtungen, z.B. Stangen, Wellen od.dgl., für die Einrichtung 18, z.B. einem auf Rollen auf den Schienen 2 verfahrbaren Schlitten, angedeutet.

Bevorzugterweise wird die erfindungsgemäße Kathodenanordnung zur Innenbeschichtung von Hohlkörpern, z.B. auch aus ferromagnetischen Stoffen, eingesetzt, da letztere z.B. mit Sputterverfahren mit einem außerhalb der Kathode erzeugten Magnetfeld aufgrund ihres abschirmenden Effektes nicht beschichtet werden können.

Das Trägerrohr 36 kann z.B. 1 - 10 mm Wandstärke aufweisen. Das die Magnete 31 einschließende Hüllrohr 35 kann 0,5 - 2 mm stark sein. Die Breite des Kühlspaltes 43 beträgt zwischen 0,3 bis 10 mm. Die Magnete 31 besitzen einen Durchmesser von etwa 5 - 50 mm. Die Rotation der Magnete erfolgt mit etwa 60 - 1200 UpM. Der gesamte Hub einer Pendelbewegung kann etwa 50 mm betragen, die Pendelfre-

quenz z.B. 1 Hz, die Vorschubgeschwindigkeit etwa 1 cm/min.

Zu bemerken ist noch, daß die Magnete 31 nicht notwendigerweise von einer Hohlwelle 30 getragen und von einem Hüllrohr 35 umgeben sein müssen. Es sind auch Ringmagnete denkbar, die zusammengeklebt sind und durch deren hohlen Kern anstatt durch die Hohlwelle 30 das Kühlmittel zugeleitet wird. Prinzipiell ist es auch möglich, das Kühlmittel durch den Spalt 43 zuzuleiten; eine bessere Wärmeabfuhr wird jedoch im erfindungsgemäßen beschriebenen Fall erreicht.

Es ist auch möglich, die Zwischenschicht 38 auf die Innenfläche der Ringe 37, 37', 37'' aufzubringen, das Trägerrohr 36 durch Abkühlen, z.B. in flüssiger Luft, zu schrumpfen und auf das geschrumpfte Trägerrohr 36 die gegebenenfalls bis unterhalb des Schmelzpunktes der Zwischenschicht 38 erwärmten Ringe 37, 37', 37'' aufzuziehen. Der Träger 4 kann von einer die Lager 3 umschließenden gegebenenfalls einstückigen Röhre gebildet sein.

Als Targetmaterial kommen auch elektrisch nicht leitende Materialien, z.B. Kunststoff, Keramik, Glas usw. in Betracht. Unter dem Begriff "Sputtern" wird auch das sogenannte "reaktive" Sputtern und auch das sogenannte RF-Sputtern verstanden, das mit einem RF (radio frequency)-Feld im Entladungsraum erfolgt.

Patentansprüche

1. Stabförmige Magnetron-Sputterkathodenanordnung mit einem innenliegenden, gekühlten Permanentmagnetsystem und einem Trägerrohr für das auf das stabförmige, vorzugsweise aus nichtmagnetischem Stahl bestehende Trägerrohr aufgebrachte, gegebenenfalls aus unterschiedlichen Targetmaterialien zusammengesetzte Target, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem aus einem oder mehreren, insbesondere austauschbar auf das Trägerrohr (36) aufgezogenen Ring(en) (37, 37', 37'') bestehenden Target und dem Trägerrohr (36) zumindest eine Wärmekontaktschicht (38) angeordnet ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zwischen dem(n) Ring(en) (37, 37', 37'') und dem Trägerrohr (36) angeordnete, vorzugsweise 5 - 50 µm, insbesondere 10 - 20 µm, dicke Wärmekontaktschicht (38) aus weichem bzw. verformbarem, insbesondere mit einer Härte < 20 MHV, niedrig schmelzendem, gut wärmeleitendem Metall bzw. einer solchen Legierung, z.B. In, Ga, Pb, Sn, Wood'sches Metall, od.dgl., besteht, die vorzugsweise auf das Trägerrohr (36) abgelagert ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Schmelzpunkt des Metalles bzw. der Legierung der Wärmekontaktschicht (38) die Temperaturen unterhalb des Erweichungspunktes oder

Schmelzpunktes des aufgetragenen Targetmaterials liegt.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall der Wärmekontaktschicht (38) einen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzt, der größer ist als der des Targetmaterials.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die gegebenenfalls in warmem Zustand auf das Trägerrohr (36) aufgetragenen Ringe (37, 37', 37'') im Betriebszustand mit Preßsitz auf dem Trägerrohr (36) bzw. der Wärmekontaktschicht (38) sitzen.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß auf das Trägerrohr (36) in axialer Richtung aufeinanderfolgend insbesondere in vorbestimmter Reihenfolge Ringe (37, 37', 37'') gegebenenfalls unterschiedlicher Breite aus unterschiedlichem Targetmaterial aufgezogen sind.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der im Inneren des Trägerrohres um dessen Längsachse insbesondere kontinuierlich rotierbare, z.B. von einer rotierbaren Welle getragenen, und vom Kühlmedium umströmte Permanentmagnete angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Magnete (31) mit in Längsrichtung des Trägerrohres (36) alternierend entgegengesetzter Richtung ihres Magnetfeldes innerhalb des Trägerrohres (36) angeordnet sind.

8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die zylindrische oder polygonale Mantelflächenbesitzenden Magnete (31) parallel und im Winkel (α) zur Längsrichtung der Elektrode (6) bzw. Welle (30) geneigt verlaufende Endflächen (44) besitzen, wobei die einander zugewandten Endflächen (44) aufeinanderfolgender Magnete (31) entgegengesetzte Magnetpole aufweisen.

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Magnete (31) eine rohrförmige Ausnehmung in Längsrichtung des Trägerrohres (36) aufweisen, mit der sie gegebenenfalls auf die Welle (30) aufgeschoben sind, daß die Ausnehmung bzw. die als Hohlwelle ausgebildete Welle (30) als Kühlmitteldurchfluß ausgebildet und an eine Kühlmittelzufuhreinrichtung (32) angeschlossen ist und daß die Magnete (31) in dem Trägerrohr (36) unter Ausbildung eines Spaltes (43) angeordnet sind, wobei der Spalt (43) zwischen dem Trägerrohr (36) und den gegebenenfalls von einem Hüllrohr (35) umgebenen Magneten (31) als Kühlmitteldurchfluß, insbesondere Kühlmittelnrückleitung, ausgebildet ist.

10. Sputterverfahren zum Sputtern mit einer Magnetron- bzw. Sputterkathodenanordnung insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 9, vorzugsweise zum Besputtern von gekrümmten Bereichen aufweisenden Flächen, z.B. den Innenflächen von Hohlkörpern, wobei die zu besputternde Fläche und die Kathodenanordnung, die ein Trägerrohr umfaßt, auf das

unterschiedliche Targetmaterialien aufgebracht sind, einer gegenseitigen Relativbewegung unterworfen, werden, wobei vorzugsweise die Kathodenanordnung lagefest gehalten und die Fläche bzw. der die Fläche tragende Körper bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Kathodenanordnung, auf deren Trägerrohr mehrere in axialer Richtung des Trägerrohres aufeinanderfolgende Ringe aus unterschiedlichem Targetmaterial aufgezogen werden, und die zu besputternde Fläche einer gegenseitigen Relativbewegung in Längsrichtung der Kathodenanordnung bzw. des Trägerrohres unterworfen werden

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Relativbewegung zwischen der Kathodenanordnung und der zu besputternden Fläche eine Pendelbewegung ist, deren Hub größer als die Breite eines, insbesondere des breitesten vorhandenen, Ringes aus Targetmaterial, gewählt ist.

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Relativbewegung eine Verschiebewegung ist und eine Vorschubbewegung des die zu besputternde Fläche tragenden Körpers in bezug auf die Längsrichtung der Kathodenanordnung (6) umfaßt, der eine Pendelbewegung überlagert ist.

13. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 10 bis 12 mit einer Verstelleinrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Kathodenanordnung (6) und/oder die zu besputternde Fläche (19) von der von einer in Längsrichtung des Trägerrohres (36) eine Vorschub- und/oder Hin- und Herbewegung (Pendelbewegung) ausführenden Trägerleinrichtung gebildeten Verstelleinrichtung (18), die gegebenenfalls von einer Förder- bzw. Antriebseinrichtung (18') betätigbar ist, getragen bzw. mit dieser verbunden sind.

14. Rohrförmiges Target insbesondere für stabförmige Magnetron- bzw. Sputterkathodenanordnungen mit einem Trägerrohr für das Targetmaterial insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 9 oder zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Trägerrohr (36) des rohrförmigen Targets und dem Targetmaterial zumindest eine vorzugsweise 5 - 50 μm , insbesondere 10 - 20 μm , dicke Wärmekontaktschicht (38) aus weichem bzw. verformbarem, insbesondere mit einer Härte $< 20 \text{ MHV}$, niedrig schmelzendem, gut wärmeleitendem Metall oder einer entsprechenden Legierung, z.B. In, Ga, Pb, Sn, W, oder'sches Metall, od.dgl. vorgesehen ist, wobei auf das Trägerrohr (36) in axialer Richtung zumindest ein, vorzugsweise eine Anzahl aufeinanderfolgender gegebenenfalls aus unterschiedlichen Targetmaterialien bestehender, gegebenenfalls unterschiedliche Breite besitzender, Ring(e) (37, 37', 37'') aufgebracht ist, wobei der (die) Ring(e) vorzugsweise in warmem Zustand auf das Trägerrohr (36) aufgezogen und nach dem Abkühlen im Betriebszu-

stand mit Preßsitz auf dem Trägerrohr (36) bzw. der Wärmekontaktschicht (38) angeordnet ist (sind), wobei gegebenenfalls das Metall der Schicht(en) (38) einen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzt, der größer ist als der des Targetmaterials.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

7

0300995

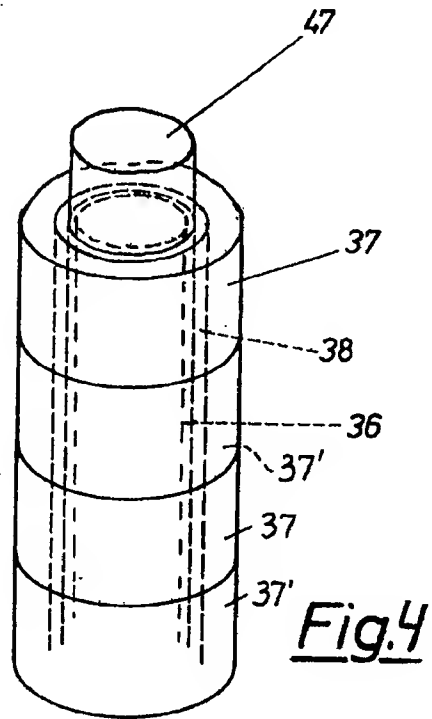
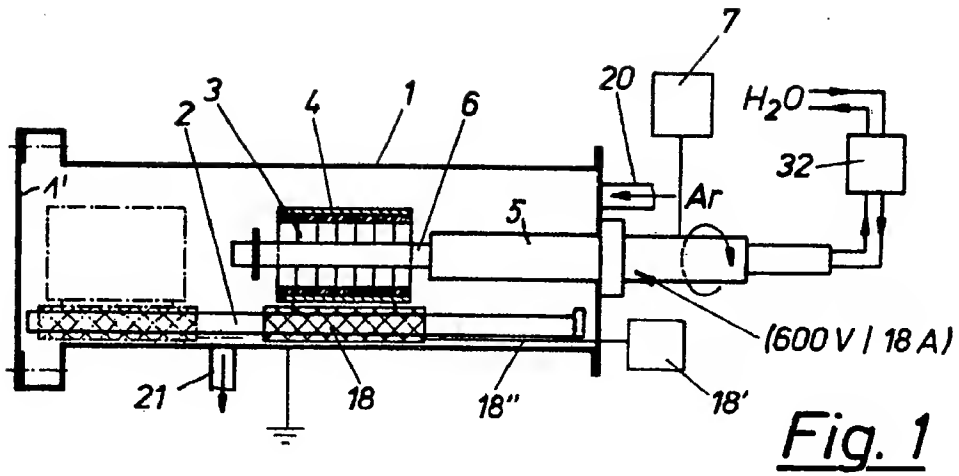


Fig. 2